

切片机技术参数要求

- 1、切片方式：半自动轮转式切片机；
- 2、显示方式：机身内置 ≥ 5 英寸彩色触控屏；
- 3、用户管理： ≥ 3 个用户，实现对不同操作用户的切片数据管理；
- 4、切片厚度：0.5-100 μm ；
- 5、切片厚度调节范围：
0.5-5 μm ，0.5 μm 增幅
5-20 μm ，1 μm 增幅
20-60 μm ，5 μm 增幅
60-100 μm ，10 μm 增幅
- 6、修片厚度：1-600 μm ；
- 7、修片厚度调节范围：
1-10 μm ，1 μm 增幅
10-20 μm ，2 μm 增幅
20-50 μm ，5 μm 增幅
50-100 μm ，10 μm 增幅
100-600 μm ，50 μm 增幅
- 8、样本回缩：0-100 μm ，5 μm 增幅；
- 9、行程范围：水平行程范围 $\geq 25\text{ mm}$ ，垂直行程范围 $\geq 70\text{ mm}$ ；
- 10、进样速度：前进后退速度 0—1800 $\mu\text{m/s}$ ，速度可自由调节；
- 11、最大样本夹头尺寸：55 mm $\times$ 55 mm
- 12、样本头角度：样本头调节角度 X/Y $\pm 8^\circ$ ，具有零位标识刻度位，且 X 轴、Y 轴均具有各 8 度的可视化刻度显示指引；
- 13、样本头记忆：具有样本头位置记忆功能，可进行一键快速定位；
- 14、大手轮力平衡系统：采用非铅块配重方式（拒绝力弹簧平衡），有效避免重金属对人体的伤害，手感轻盈，操作轻松；
- 15、大手轮锁定：具有 2 种锁定装置，可在最高点锁定和任意位置锁定；可通过屏幕上锁定图标颜色直观显示大手轮状态。
- 16、大手轮具有专用半刀修片拇指位人体工学设计，方便半刀修片；
- 17、刀架功能：可精准侧向位移，无需移动刀片即可保证刀片全长刀口使用，兼

容宽刀和窄刀，内置护刀器和退刀装置；

18、刀架结构：刀架采用燕尾槽结构的底座（拒绝双导轨结构），前后移动和锁定更精准、稳定；

19、刀座快速定位：具有快速定位位置和角度的刻度指示，位置范围为：0-2.5cm，调整角度范围为：0-10°；。

20、粗修方式：≥4种，且必须具有小手轮粗修方式；

21、样本头进样方式：≥3种，至少包括小手轮、外接独立操作控制器、机身左侧按键面板；

22、小手轮功能：左侧粗修小手轮，具有≥3种方式操作（包含但不限于手柄、转盘、手指盘）；

23、小手轮速度：小手轮控制样本进样速度可调，速度范围 50 μm/r——500 μm/r；

24、小手轮定位：小手轮转动有细分定位，细分位≥100分格，每转动一分格，样本头前进或者后退幅度可调，调整范围为 0.5μm——5 μm；

25、小手轮调节：粗修小手轮进样方向、速度可通过软件快速实时调节，适应不同操作者使用习惯；

26、半刀修片功能：大手轮转动角度≥10°即可触发修片模式，半刀修片完成后整圈转动手轮，即可自动切换到切片模式；

27、整机设计：整机符合人体工程学，机身采用全包裹式设计，具有大容量置物台，置物台面积≥660cm²；

28、废屑收集盘：容积≥2L，采用磁吸结构和防静电设计，减少石蜡粘附，易拆卸易清洁；

29、数据接口：设备内置可拓展接口 USB 接口≥2个，网线接口≥1个，串行通信接口≥1个，可实现数据导入导出、软件升级更新、外接扫描枪、设备有线联网及外接控制面板等功能